适配板材

★ 中高Tg无卤环氧

★ BT/类BT

★ PPO/PPE

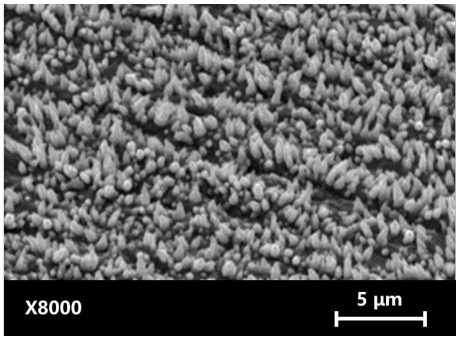
R-FL3

典型应用

★ 精细线路

★ HDI 高密度互联

★ HSD 高速数字电路 (Ultra low loss)



技术指标

项目		单位	规格参数	测试方法
标称厚度		μm	12	IPC-4562A
单位面积质量		g/m²	107	IPC-TM-650 2.2.12
抗拉强度	常温	MPa	360	IPC-TM-650 2.4.18
	180℃		180	
延伸率	常温	%	8.0	
	180℃		5.0	
粗糙度 Rz	压合面	μm	1.5	IPC-TM-650 2.2.17
	阻剂面		3.0	
剥离强度	PPO	lb/inch	3.0	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。